# 深圳市科技创新委员会2022年集成电路

# 专项资助计划项目申请指南

一、申请内容

（一）对集成电路设计企业流片支持

1.多项目晶圆直接流片资助；

2.首次完成全掩膜工程产品流片资助。

（二）对集成电路设计企业购买IP（硅知识产权）支持

对于企业购买IP开展高端芯片研发，给予IP购买费用资助。

（三）对集成电路EDA设计工具研发支持

对于从事集成电路EDA设计工具研发的企业，给予EDA研发费用资助。

二、设定依据

（一）《深圳市人民政府关于印发进一步推动集成电路产业发展行动计划（2019-2023年）的通知》(深府〔2019〕28号)；

（二）《深圳市人民政府办公厅关于印发加快集成电路产业发展若干措施的通知》（深府办规〔2019〕4号）。

（三）《深圳市科技计划项目管理办法》(深科技创新规〔2019〕1号；

（四）《深圳市科技研发资金管理办法》(深科技创新规〔2019〕2号)；

（五）《深圳市企业研究开发项目与高新技术企业培育项目资助管理办法》（深科技创新规〔2019〕5号）。

三、支持强度与方式

支持强度：有数量限制，受科技研发资金年度总额控制。按照**审计结果**确定资助额度，本批次资助资金纳入2022年市级财政预算安排。

（一）对集成电路设计企业流片支持

1.对于使用多项目晶圆进行研发的企业，给予2020年多项目晶圆直接流片费用最高70%、年度总额不超过300万元的资助；

2.对于首次完成全掩膜工程产品流片的企业，给予2020年首次完成全掩膜工程产品流片费用最高50%、年度总额不超过500万元的资助。

（二）对集成电路设计企业购买IP支持

对于购买IP开展高端芯片研发的企业，给予2020年IP购买实际支付费用最高20%的资助，单个企业每年总额不超过500万元。

（三）对集成电路EDA设计工具研发支持

对于从事集成电路EDA设计工具研发的企业，给予2020年EDA研发费用实际支出最高30%的研发资助，总额不超过3000万元。

支持方式：事后资助。

四、申请条件

（一）基本条件：

1.申请单位应当是在深圳市（含深汕特别合作区，下同）依法注册，具备法人资格的企业；

2.申请单位应在深圳具备研发的场地、设施、人员等；

3.申请单位未列入深圳市科研诚信异常名录；

4.申请单位无逾期未办理验收的项目；

5.申请单位同一项目不得向市有关部门进行多头申请和重复申请；

（二）专项条件：

1.对集成电路设计企业流片支持

（1）申请单位应为集成电路设计企业；

（2）申请单位应为流片产品的知识产权所有方；

（3） 项目未申请市发展改革委集成电路设计流片扶持计划。

2.对集成电路设计企业购买IP支持

（1）申请单位应为集成电路设计企业；

（2）申请单位应为IP授权协议中的知识产权最终被授予方，且不再转售予第三方；

（3）IP购买实际支付费用应为IP授权费用（不含版税费用）。

3.对集成电路EDA设计工具研发支持

（1）申请单位应为从事集成电路EDA设计工具研发企业；

（2）研究开发活动应符合研发费用加计扣除政策范畴，且2020年度已向税务部门办理加计扣除申报。

五、申请材料

（一）基本材料：

1.2020年度完税证明复印件；

2.经深圳市注册会计师协会备案的**含有防伪标识**封面的2020年度研发投入专项审计报告复印件（报告应包含资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表及附注、集成电路设计（或EDA设计工具研发）的研发场地、研发团队、软硬件设施、研究开发费用及经费来源等内容），研究开发费用计算范围和计算比例按照《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119号）、《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第40号）等政策文件的规定执行；

3.知识产权合规性申明原件;

4.科研诚信承诺书原件；

5.可以选择提供集成电路设计（或EDA设计工具研发）相关的知识产权证(例如专利和软件著作权等)证明材料复印件。

（二）专项材料：

1.对集成电路设计企业流片支持

（1）深圳市集成电路专项资助计划流片及IP资助项目申请书原件；

（2）集成电路制造企业出具的2020年度产品加工发票及相应的加工订单、银行支付凭证等复印件,境外加工的集成电路产品需提供相应的清关凭证或本产品的完税证明复印件；

（3）通过专业服务机构流片的申请单位需另外提供专业服务机构与申请单位签署的合同、发票、银行支付凭证等复印件

**（加工订单、加工发票、银行支付凭证、清关凭证/完税证明应依次排序，按照每一个产品单独、有序分开。英文合同/订单请提供中文翻译件）**

（4）产品版图缩略图A4版彩色打印件；

（5）首次全掩膜产品流片需提供该产品布图设计登记证书复印件。

2.对集成电路设计企业购买IP支持

（1）深圳市集成电路专项资助计划流片及IP资助项目申请书原件；

（2）2020年度购买IP的发票及相应的合同、银行支付凭证等复印件，购买进口IP的另需提供相应的完税证明复印件；

（3）合同不含IP原厂授权条款的，需提供申报企业与IP原厂直接签署的IP授权协议复印件。

**（合同/授权协议、发票、银行支付凭证、完税证明应依次排序，按照每一个IP单独、有序分开。英文合同/授权协议请提供中文翻译件）**

3.对集成电路EDA设计工具研发支持

深圳市集成电路专项资助计划EDA设计工具研究开发资助项目申请书原件。

六、申请表格

本指南规定提交的表格，申请单位登录深圳市科技业务管理系统在线填报。

七、受理机关

（一）受理机关：深圳市科技创新委员会。

（二）受理时间：

网络填报受理时间：2021年7月5日-2021年8月4日（截止24:00）。

申请单位在网上填报受理时限内登录深圳市科技业务管理系统在线填报《深圳市集成电路专项资助计划项目申请书》，并在科技业务系统中上传其他申请材料的电子版扫描件（复印件需加盖申请单位公章后扫描）后提交审核（系统受理状态为“待窗口受理”）。

（三）书面材料提交时间：项目入库后提交纸质书面材料，具体提交时间和方式另行通知。

（四）联系电话：86168829、86168821

 技术支持：86576087、86576088

八、决定机关

深圳市科技创新委员会。

九、审批程序

网上申报——电子材料初审——委托审计——项目审定——社会公示——项目入库——提交纸质材料——下达计划——拨付资金。

十、审批时限

成批处理。

十一、证件及有效期限

证    件：批准文件。

有效期限：申请单位在收到批准文件之日起1个月内办理资金拨付。

十二、法律效力

申请单位凭批准文件获得市科技研发资金资助。

十三、收费

不收费。

十四、年审或年检

无年审。

**声 明：**申请人和申请单位对申请材料的合法性、真实性、准确性和完整性负责。对抄袭剽窃或弄虚作假的，我委核实后将不予立项或撤销项目，并纳入科研诚信异常名录，同时视情节轻重，依法依规追究相应责任。

**市科技创新委从未委托任何单位或个人为项目申请单位代理资金申请事宜，申请单位必须自主申请。凡是购买、委托代写项目申请书的，或是提供虚假证明材料的，一经发现并查实，即视为骗取财政资金，一律不予受理、取消申请资格或撤销立项项目，并按规定严肃处理。市科技创新委将严格按照有关标准和程序受理，不收取任何费用。如有任何中介机构和个人假借市科技创新委领导和工作人员名义向申请单位收取费用的，请知情者即向市科技创新委举报。**

**项目申请单位需提交审计报告的，应当按照《深圳市科技计划项目管理办法》等规定，提供经深圳市注册会计师协会备案的含有防伪标识封面的审计报告。项目申请单位提供无防伪标识封面（未备案）或属于虚假防伪标识封面（未备案）的审计报告，市科技创新委员会不予采用。 相关审计报告经核查认定属于虚假材料的，项目单位五年内不得申请市科技计划项目，市科技创新委员会将其列入科研诚信异常名录，并按照市政府失信联合惩戒有关规定予以处理。**

 **特别说明：本指南中的多项目晶圆（MPW），指将多个使用相同工艺的不同的集成电路设计项目放在同一晶圆片上流片；首次全掩膜工程产品流片，指集成电路设计项目第一次全部层次制版流片，不包括改版；IP（硅知识产权、集成电路IP核），指具有知识产权的、经过验证的、可重复利用、非独家授权的集成电路模块；专业服务机构特指专业从事流片服务、或从事包含流片服务业务的集成电路设计服务企业或单位。**